

CF-E11 考核項目提示

1. 使用前檢查機台狀況?
 - a. 燈號、機台狀況標示
2. 貼片時注意事項?
 - a. 先將載片背面用 IPA 擦拭乾淨
 - b. 放在乾淨無塵布上
 - c. 再開始貼片
 - d. 若載片正面已經髒汙，則更換載片
3. 各腔體功能?
 - a. PM1:?
 - b. PM2:?
 - c. PM3:?
4. Recipe 選定與參數修改?
 - a. 如何從主畫面下 run 頁面連接至 recipe 頁面? 實際操作
 - b. 如何判斷蝕刻步驟: RF power on
 - c. 如何修改製程時間: 實際操作
 - d. De-chuck step 作用為何? 去除靜電，切勿更改到 de-chuck 參數
5. He 背壓用途與數值異常(變高)原因?
 - a. He 背壓功能: 使 wafer 溫度均勻
 - b. He 背壓變大原因: 晶背髒、晶片變形(少見)
 - c. 如何防止 He 背壓變大: 使用前務必先將晶背擦拭乾淨
6. Alarm 處理流程?
 - a. 先讓 alarm 重新執行: 先從 retry、restart、continue 選擇
 - b. 若無法解除，則將 wafer 傳回來: 選回傳 wafer 的項目
 - c. 若無法回傳，先回主畫面按 Abort，先將還沒做的 wafer 回傳
 - d. 掛紅牌，留下聯絡方式
 - e. 若是遇到 沒看過、不確定、無法理解的 alarm 訊息，
不曉得如何選擇的話: 直接掛紅牌，留下聯絡方式
7. 下錯 recipe 處理方法?
 - a. Abort 將晶片退回
 - b. 手動跳過蝕刻 ME 步驟